

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG GRACE SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹宏力半導體有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：1347)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條而作出。

茲載列華虹宏力半導體有限公司（「本公司」）於上海證券交易所網站刊發的

- 1、關於募集資金投資項目結項、變更及超募資金用於投資新項目和永久補充流動資金的公告
- 2、國泰海通證券股份有限公司關於華虹宏力半導體有限公司募集資金投資項目結項、變更及超募資金用於投資新項目和永久補充流動資金的核查意見

僅供參閱。

承董事會命
華虹宏力半導體有限公司
董事會主席兼執行董事
白鵬博士

中國上海，二零二六年九月四日

於本公告日期，本公司董事分別為：

執行董事：

白鵬 (主席兼總裁)

非執行董事：

葉峻

孫國棟

陳博

熊承艷

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壩太平紳士

封松林

A 股代码：688347

A 股简称：华虹宏力

公告编号：2026-048

港股代码：01347

港股简称：华虹宏力

华虹宏力半导体有限公司

关于募集资金投资项目结项、变更及超募资金用于投资新项目和永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次变更及结项的募集资金投资项目：8 英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目。
- 本次结项的募集资金投资项目：华虹制造（无锡）项目。
- 新项目：华虹宏力无锡三期（以下简称“新项目”、“无锡三期项目”）。
- 华虹宏力半导体有限公司（以下简称“公司”）拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金 303,056.29 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）、8 英寸厂优化升级项目和特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金 252,540.87 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）投资建设新项目，新项目的其余部分资金由公司自有资金方式投入。
- 公司拟使用华虹制造（无锡）项目结项后的剩余募集资金 15,064.81 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。
- 上述事项已经公司于 2026 年 9 月 4 日召开的董事会审议通过，其中公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8 英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目剩余募集资金和自有资金投资建设新项目的事项，尚需提交公司股东大会审议。

- 本次募集资金投资项目不涉及关联交易，不构成重大资产重组。
- 相关风险提示：尽管公司已对本次拟使用部分募投项目剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设的新项目进行了充分的可行性研究和论证，但在项目实施过程中，仍不排除可能出现项目实施风险、市场风险、管理风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计28,232.30万元（含税）后，募集资金净额为2,092,067.70万元，上述资金于2023年7月31日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第60985153_B02号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，募集资金投资项目及拟使用募集资金总额情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金金额（万元）
1	华虹制造（无锡）项目	1,250,000.00
2	8英寸厂优化升级项目	200,000.00
3	特色工艺技术创新研发项目	250,000.00
4	补充流动资金	100,000.00
合 计		1,800,000.00

二、本次变更募投项目投资总额并结项的情况

（一）8英寸厂优化升级项目

1、项目变更基本情况表

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年首次公开发行募集资金之 8 英寸厂优化升级项目
募集资金承诺使用金额	200,000.00
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 日
涉及变更投向的总金额	125,733.99
涉及变更投向的总金额占比	62.87%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☒ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

本项目内容为通过升级8英寸厂的部分生产线，以匹配嵌入式非易失性存储器等特色工艺平台技术需求，同时升级8英寸厂的功率器件工艺平台生产线。项目实施过程中，通过更新包括干法刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、湿法刻蚀清洗设备、CMP研磨设备及量检测设备等多种设备，在产能利用率、工艺平台创新及丰富等重要的业务指标上实现了既定目标，并保障了公司8英寸产线产能的高效利用和核心竞争力的进一步提升。公司根据市场变化，在满足生产及工艺需求的前提下，根据市场需求变化动态调整实际投入；此外，部分原计划使用募集资金购置的设备实际使用其他资金支付以及增加国产设备采购占比等因素均降低募集资金实际使用金额。公司结合最新经营情况及近期市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟调减8英寸厂优化升级项目的投资总额，并将该项目结项。

3、募集资金后续安排

公司拟将8英寸厂优化升级项目调减的125,733.99万元剩余募集资金，用于投资建设新项目，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

（二）特色工艺技术创新研发项目

1、项目变更基本情况表

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年首次公开发行募集资金之特色工艺技术创新研发项目
募集资金承诺使用金额	250,000.00
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 日
涉及变更投向的总金额	122,944.47
涉及变更投向的总金额占比	49.18%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☒ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

本项目内容为用于上海公司各大特色工艺平台技术研发，包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等方向，具体用于包括但不限于与上述研发活动相关的设备和无形资产购置费用、维护维修费、研发人员的薪资福利、直接材料等。特色工艺技术创新研发项目以公司原有特色工艺技术为基础，通过进一步深化研究，实现特色工艺技术平台拓展和升级，提升特色工艺平台竞争力，并最终服务于产品线。项目实施过程中，公司在保证既定目标前提下，严格控制成本，持续加强项目各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出。公司结合最新经营情况及近期市场拓展进度，经综合评估，

为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟调减特色工艺技术创新研发项目的投资总额，并将该项目结项。

3、募集资金后续安排

公司拟将8英寸厂优化升级项目调减的122,944.47万元剩余募集资金，用于投资建设新项目，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

三、本次募集资金投资项目结项及剩余募集资金情况

（一）项目结项及募集资金剩余情况

结项名称	2023 年首次公开发行募集资金之华虹制造（无锡）项目
结项时间	2026 年 8 月 14 日
募集资金承诺使用金额	<u>1,250,000.00</u> 万元
募集资金实际使用金额	<u>1,242,736.42</u> 万元
剩余募集资金金额	<u>15,064.81</u> 万元
剩余募集资金使用用途及相应金额	☐ 在建项目，项目名称，____ 万元 ☐ 新项目，项目名称，____ 万元 ☒ 补流， <u>15,064.81</u> 万元 ☐ 偿还银行借款，____ 万元 ☐ 其他，具体用途，____ 万元

注：截至 2026 年 8 月 14 日本项目剩余募集资金金额包含募集资金专户累计利息收入扣除手续费等后的净额，实际剩余金额以资金转出当日专户余额为准。

（二）募集资金剩余的主要原因

在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效利用的原则，在保证项目实施质量和周期的前提下，审慎地使用募集资金。公司根据市场实际需求及公司战略规划的变化，在充分满足工艺技术要求的前提下，对原设备采购方案进行了适当优化调整，合理

降低了部分设备采购金额；同时，公司持续加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出，因此形成部分剩余募集资金。

（三）剩余募集资金的使用计划

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余募集资金15,064.81万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额）全部用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营及业务发展的资金需求，剩余募集资金的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

四、超募资金使用及安排

公司首次公开发行并募集资金之超募资金金额为292,067.70万元，截至本公告日，超募资金尚未使用。为提高募集资金使用效率，公司拟将超募资金预计剩余金额303,056.29万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额）用于投资建设新项目，超募资金的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

五、本次使用超募资金、剩余募集资金和自有资金投资新项目的具体情况

为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金和自有资金投资建设华虹宏力无锡三期项目，具体如下：

（一）项目基本情况

1、项目名称：华虹宏力无锡三期

2、建设地点：无锡市新吴区新洲路30-2号

3、项目实施主体：无锡华虹宏力三期半导体有限公司

4、项目建设周期：预计于2027年12月完成项目产线建设并投入生产

5、项目建设内容：无锡三期项目总投资69.5亿美元，利用公司无锡基地现有生产和动力厂房新建洁净室和动力系统，并配置相应的工艺设备、量测和辅助设备、自动搬运系统及生产管理系统，坚持自主研发与适当引进的方式构建特色工

艺技术平台，建设一条月产能达到5.5万片的12英寸特色工艺生产线。该项目将进一步完善并延展逻辑与射频（含图像传感器）、非易失性存储器等工艺平台。

6、投资金额及资金来源：项目将采用资本金及银行贷款的方式完成资金筹措，计划投资金额69.5亿美元。公司拟使用剩余超募资金余额303,056.29万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额），8英寸厂优化升级项目结项变更的剩余募集资金127,556.11万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额），特色工艺技术创新研发项目结项变更的剩余募集资金124,984.76万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额），合计555,597.15万元用于项目资本金出资，主要用于购置生产设备及厂务设施。公司及全资子公司的合计资本金出资为21.27亿美元，出资不足的部分公司将以自有或自筹资金投入补足（详见8、项目投资计划）。

7、募集资金的具体使用规划：本项目拟主要使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金、8英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目剩余募集资金，购置新项目的生产设备及厂务设施，预计于2027年12月前使用完毕。

8、项目投资计划

项目具体投资计划如下：

序号	项目	总投资金额（亿美元）	拟使用资金来源
1	生产设备购置及安装费	58.00	募集资金及自有资金
2	建筑安装工程	8.37	自有资金或自筹资金
3	工程建设其他费用	1.68	自有资金或自筹资金
4	预备费	0.18	自有资金或自筹资金
5	建设期利息	0.12	自有资金或自筹资金
6	铺底流动资金	1.15	自有资金或自筹资金
合计		69.50	-

（二）项目实施的必要性

公司无锡基地已先后完成两条12英寸产线的建设，并建立起从人才管理团队、“特色IC+功率器件”等五大特色工艺平台到基础研发和生产营运的完整管理体系。

为了进一步夯实在先进特色工艺领域的市场地位，提升特色工艺技术能级，巩固和提高自身核心竞争力，满足国产化和新应用领域的需求，拟实施华虹宏力无锡三期项目进行产能扩充及技术升级。

（三）项目实施的可行性

无锡三期项目具备较高的执行可行性，主要体现在以下方面：1、政策支持，本项目已获国家行业主管部门的指导意见批复，并取得了地方政府在配套政策上的支持；2、技术与生产工艺平台，依托华虹宏力上市公司的行业地位及在特色工艺领域的深度积累，具备在相关技术领域方面较强的护城河及市场竞争力；3、资金与资本保障，在国家及地方相关集成电路领域投资基金的支持下，项目已获得了资金方面的坚实保障，相关资本开支及营运资金均有充分保障；4、市场与经济效益，随着半导体领域国产化需求的不断提升，项目达产后预计将具备良好的市场需求和盈利预期，并有效带动本地区产业链的发展，成为国内先进特色工艺领域重要的组成部分。

（四）项目实施的风险分析

本项目在资金筹措、人才技术、产品市场、经营管理等方面均风险可控，具备较好的抗风险能力。公司也会不断加强内部管理，降低成本消耗，保持技术先进性，开发新工艺及产品，尽可能开拓市场，始终以先进技术把握市场的发展方向，确保较高的项目经营安全率，规避项目的经营风险。

（五）项目效益情况

本项目系公司为进一步扩大产能、提升工艺平台和产品能力先进性，巩固自身行业优势地位所作的重要战略性投资。根据项目的投资周期，经财务收益测算，预计本项目在渡过主要设备折旧期后，将显著增厚公司的利润水平，因此具备经济效益。

（六）保障超募资金及剩余募集资金的管理措施

本项目相关审批程序履行完成后，相关项目实施主体将根据实际情况新增开

立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金和剩余募集资金，并与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方/四方监管协议等相关事宜。公司将根据新项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。在项目实施过程中，公司将根据项目实施进度，在本次审议的总投资额度内以超募资金、剩余募集资金和自有资金通过增资等形式对项目实施主体进行支付，每次支付的具体金额、时机等事项及与本次新项目相关的其他具体事项，董事会授权公司管理层具体决定并组织相关部门执行。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金是基于公司发展战略、当前市场情况和公司实际经营需求做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，新项目的实施有助于公司实现战略目标，把握半导体行业发展机遇，通过优化产业布局和适度扩大半导体产能规模，增强市场竞争优势，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

七、审议程序及专项意见说明

（一）审议程序

公司于2026年9月4日召开董事会，审议通过了公司拟使用华虹制造（无锡）项目结项后的剩余募集资金用于永久补充流动资金事项及公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金和自有资金投资建设华虹宏力无锡三期项目的事项。

其中公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金和自有资金投资建设新项目的，尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审核委员会意见

经审议，董事会审核委员会认为：公司本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金是基于公司业务开展的实际需要，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司章程的规定。

综上所述，董事会审核委员会同意公司本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会审核委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司拟使用超募资金、剩余募集资金和自有资金投资建设新项目事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金投资项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金，符合公司经营发展和业务规划需要，有利于公司长远发展及提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项无异议。

八、上网公告附件

《国泰海通证券股份有限公司关于华虹宏力半导体有限公司募集资金投资项目结项、变更及超募资金用于投资新项目和永久补充流动资金的核查意见》

特此公告。

华虹宏力半导体有限公司董事会

2026年9月5日

国泰海通证券股份有限公司

关于华虹宏力半导体有限公司

募集资金投资项目结项、变更及超募资金用于投资新项目 和永久补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为华虹宏力半导体有限公司（以下简称“华虹宏力”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对华虹宏力募集资金投资项目结项、变更及超募资金用于投资新项目和永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年6月6日出具的《关于同意华虹半导体有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1228号），公司获准向社会公开发行人民币普通股40,775.00万股，每股发行价格为人民币52.00元，募集资金总额为2,120,300.00万元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计28,232.30万元（含税）后，募集资金净额为2,092,067.70万元，上述资金于2023年7月31日已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“安永华明（2023）验字第60985153_B02号”《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司已对募集资金实行专户存储管理。上述募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户监管协议。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书，募集资金投资项目及拟使用募集资金总额情况如下：

序号	募集资金投资项目	拟使用募集资金金额（万元）
----	----------	---------------

1	华虹制造（无锡）项目	1,250,000.00
2	8英寸厂优化升级项目	200,000.00
3	特色工艺技术创新研发项目	250,000.00
4	补充流动资金	100,000.00
合 计		1,800,000.00

二、本次变更募投项目投资总额并结项的情况

（一）8英寸优化升级项目

1、项目变更基本情况表

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年首次公开发行募集资金之 8 英寸厂优化升级项目
募集资金承诺使用金额	200,000.00
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 日
涉及变更投向的总金额	125,733.99
涉及变更投向的总金额占比	62.87%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☒ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

本项目内容为通过升级 8 英寸厂的部分生产线，以匹配嵌入式非易失性存储器等特色工艺平台技术需求，同时升级 8 英寸厂的功率器件工艺平台生产线。项目实施过程中，通过更新包括干法刻蚀设备、薄膜沉积设备、离子注入设备、湿法刻蚀清洗设备、CMP 研磨设备及量检测设备等多种设备，在产能利用率、工艺平台创新及丰富等重要的业务指标上实现了既定目标，并保障了公司 8 英寸产线产能的高效利用和核心竞争力的进一步提升。公司根据市场变化，在满

足生产及工艺需求的前提下，根据市场需求变化动态调整实际投入；此外，部分原计划使用募集资金购置的设备实际使用其他资金支付以及增加国产设备采购占比等因素均降低募集资金实际使用金额。公司结合最新经营情况及近期市场拓展进度，经综合评估，为避免盲目投资带来设备闲置损耗，保障募集资金使用的合理性，维护公司和全体股东的利益，公司拟调减 8 英寸厂优化升级项目的投资总额，并将该项目结项。

3、募集资金后续安排

公司拟将 8 英寸厂优化升级项目调减的 125,733.99 万元剩余募集资金，用于投资建设新项目，并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

（二）特色工艺技术创新研发项目

1、项目变更基本情况表

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元 币种：人民币

项目名称	2023 年首次公开发行募集资金之特色工艺技术创新研发项目
募集资金承诺使用金额	250,000.00
募集资金到账时间	2023 年 7 月 31 日
涉及变更投向的总金额	122,944.47
涉及变更投向的总金额占比	49.18%
改变募集资金用途类型	☐ 改变募集资金投向 ☐ 改变募集资金金额 ☐ 取消或者终止募集资金投资项目 ☐ 改变募集资金投资项目实施主体 ☐ 改变募集资金投资项目实施方式 ☒ 实施新项目 ☐ 永久补充流动资金 ☐ 其他：_____

注：“涉及变更投向的总金额占比”为涉及变更投向的总金额占项目承诺募集资金使用金额的比例。

2、项目变更的具体原因

本项目内容为用于上海公司各大特色工艺平台技术研发，包括嵌入式/独立式非易失性存储器、功率器件、模拟与电源管理、逻辑与射频等方向，具体用于包括但不限于与上述研发活动相关的设备和无形资产购置费用、维护维修费、

研发人员的薪资福利、直接材料等。特色工艺技术创新研发项目以公司原有特色工艺技术为基础,通过进一步深化研究,实现特色工艺技术平台拓展和升级,提升特色工艺平台竞争力,并最终服务于产品线。项目实施过程中,公司在保证既定目标前提下,严格控制成本,持续加强项目各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低了项目总支出。公司结合最新经营情况及近期市场拓展进度,经综合评估,为避免盲目投资带来设备闲置损耗,保障募集资金使用的合理性,维护公司和全体股东的利益,公司拟调减特色工艺技术创新研发项目的投资总额,并将该项目结项。

3、募集资金后续安排

公司拟将 8 英寸厂优化升级项目调减的 122,944.47 万元剩余募集资金,用于投资建设新项目,并继续按照募集资金相关法律、法规要求进行存放和管理。

三、本次募集资金投资项目结项及剩余募集资金情况

(一) 项目结项及募集资金剩余情况

结项名称	2023 年首次公开发行募集资金之华虹制造（无锡）项目
结项时间	2026 年 8 月 14 日
募集资金承诺使用金额	<u>1,250,000.00</u> 万元
募集资金实际使用金额	<u>1,242,736.42</u> 万元
剩余募集资金金额	<u>15,064.81</u> 万元
剩余募集资金使用用途及相应金额	☐ 在建项目, 项目名称, ____万元 ☐ 新项目, 项目名称, ____万元 ☒ 补流, <u>15,064.81</u> 万元 ☐ 偿还银行借款, ____万元 ☐ 其他, 具体用途, ____万元

注: 截至 2026 年 8 月 14 日本项目剩余募集资金金额包含募集资金专户累计利息收入扣除手续费等后的净额, 实际剩余金额以资金转出当日专户余额为准。

(二) 募集资金剩余的主要原因

在项目实施过程中, 公司严格按照募集资金使用的有关规定, 从项目的实

际情况出发，本着合理、节约、有效利用的原则，在保证项目实施质量和周期的前提下，审慎地使用募集资金。公司根据市场实际需求及公司战略规划的变化，在充分满足工艺技术要求的前提下，对原设备采购方案进行了适当优化调整，合理降低了部分设备采购金额；同时，公司持续加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低了项目总支出，因此形成部分剩余募集资金。

（三）剩余募集资金的使用计划

鉴于上述项目已达到预定可使用状态，为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余募集资金 15,064.81 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额）全部用于永久补充流动资金，以满足公司日常经营及业务发展的资金需求，剩余募集资金的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

四、超募资金使用及安排

公司首次公开发行并募集资金之超募资金金额为 292,067.70 万元，截至本公告日，超募资金尚未使用。为提高募集资金使用效率，公司拟将超募资金预计剩余金额 303,056.29 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额）用于投资建设新项目，超募资金的具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

五、本次使用超募资金、剩余募集资金和自有资金投资新项目的具体情况

为提高公司募集资金使用效率，公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8 英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金和自有资金投资建设华虹宏力无锡三期项目，具体如下：

（一）项目基本情况

- 1、项目名称：华虹宏力无锡三期
- 2、建设地点：无锡市新吴区新洲路 30-2 号
- 3、项目实施主体：无锡华虹宏力三期半导体有限公司
- 4、项目建设周期：预计于 2027 年 12 月完成项目产线建设并投入生产
- 5、项目建设内容：华虹宏力无锡三期项目总投资 69.5 亿美元，利用公司无

锡基地现有生产和动力厂房新建洁净室和动力系统，并配置相应的工艺设备、量测和辅助设备、自动搬运系统及生产管理系统，坚持自主研发与适当引进的方式构建特色工艺技术平台，建设一条月产能达到 5.5 万片的 12 英寸特色工艺生产线。该项目将进一步完善并延展逻辑与射频（含图像传感器）、非易失性存储器等工艺平台。

6、投资金额及资金来源：项目将采用资本金及银行贷款的方式完成资金筹措，计划投资金额 69.5 亿美元。公司拟使用剩余超募资金余额 303,056.29 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额），8 英寸厂优化升级项目结项变更的剩余募集资金 127,556.11 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额），特色工艺技术创新研发项目结项变更的剩余募集资金 124,984.76 万元（包含累计利息收入扣除手续费等后的净额），合计 555,597.15 万元用于项目资本金出资，主要用于购置生产设备及厂务设施。公司及全资子公司的合计资本金出资为 21.27 亿美元，出资不足的部分公司将以自有或自筹资金投入补足（详见 8、项目投资计划）。

7、募集资金的具体使用规划：本项目拟主要使用公司首次公开发行并募集资金之超募资金、8 英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目剩余募集资金，购置新项目的生产设备及厂务设施，预计于 2027 年 12 月前使用完毕。

8、项目投资计划

项目具体投资计划如下：

序号	项目	总投资金额（亿美元）	拟使用资金来源
1	生产设备购置及安装费	58.00	募集资金及自有资金
2	建筑安装工程	8.37	自有资金或自筹资金
3	工程建设其他费用	1.68	自有资金或自筹资金
4	预备费	0.18	自有资金或自筹资金
5	建设期利息	0.12	自有资金或自筹资金
6	铺底流动资金	1.15	自有资金或自筹资金
合计		69.50	-

（二）项目实施的必要性

公司无锡基地已先后完成两条 12 英寸产线的建设，并建立起从人才管理团队、“特色 IC+功率器件”等五大特色工艺平台到基础研发和生产营运的完整管理体系。为了进一步夯实在先进特色工艺领域的市场地位，提升特色工艺技术能级，巩固和提高自身核心竞争力，满足国产化和新应用领域的需求，拟实施华虹宏力无锡三期项目进行产能扩充及技术升级。

（三）项目实施的可行性

无锡三期项目具备较高的执行可行性，主要体现在以下方面：1、政策支持，本项目已获国家行业主管部门的指导意见批复，并取得了地方政府在配套政策上的支持；2、技术与生产工艺平台，依托华虹宏力上市公司的行业地位及在特色工艺领域的深度积累，具备在相关技术领域方面较强的护城河及市场竞争力；3、资金与资本保障，在国家及地方相关集成电路领域投资基金的支持下，项目已获得了资金方面的坚实保障，相关资本开支及营运资金均有充分保障；4、市场与经济效益，随着半导体领域国产化需求的不断提升，项目达产后预计将具备良好的市场需求和盈利预期，并有效带动本地区产业链的发展，成为国内先进特色工艺领域重要的组成部分。

（四）项目实施的风险分析

本项目在资金筹措、人才技术、产品市场、经营管理等方面均风险可控，具备较好的抗风险能力。公司也会不断加强内部管理，降低成本消耗，保持技术先进性，开发新工艺及产品，尽可能开拓市场，始终以先进技术把握市场的发展方向，确保较高的项目经营安全率，规避项目的经营风险。

（五）项目效益情况

本项目系公司为进一步扩大产能、提升工艺平台和产品能力先进性，巩固自身行业优势地位所作的重要战略性投资。根据项目的投资周期，经财务收益测算，预计本项目在渡过主要设备折旧期后，将显著增厚公司的利润水平，因此具备经济效益。

（六）保障超募资金及剩余募集资金的管理措施

本项目相关审批程序履行完成后，相关项目实施主体将根据实际情况新增开立募集资金专用账户，专项存储投入的超募资金和剩余募集资金，并与公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储监管协议，董事会授权公司管理层办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储三方/四方监管协议等相关事宜。公司将根据新项目的实施进度，逐步投入募集资金并对项目实施单独建账核算。在项目实施过程中，公司将根据项目实施进度，在本次审议的总投资额度内以超募资金、剩余募集资金和自有资金通过增资等形式对项目实施主体进行支付，每次支付的具体金额、时机等事项及与本次新项目相关的其他具体事项，董事会授权公司管理层具体决定并组织相关部门执行。公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定实施监管监督，并根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

六、本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金对公司的影响

本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金是基于公司发展战略、当前市场情况和公司实际需求做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，新项目的实施有助于公司实现战略目标，把握半导体行业发展机遇，通过优化产业布局和适度扩大半导体产能规模，增强市场竞争优势，不会对公司的生产经营产生重大不利影响，符合公司和全体股东的利益。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，加强募集资金使用的管理，确保募集资金使用的合法、有效。

七、审议程序及审核意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年9月4日召开董事会，审议通过了公司拟使用华虹制造（无锡）

项目结项后的剩余募集资金用于永久补充流动资金事项及公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金和自有资金投资建设华虹宏力无锡三期项目的事项。

其中公司拟使用首次公开发行并募集资金之超募资金、8英寸厂优化升级项目及特色工艺技术创新研发项目结项形成的剩余募集资金和自有资金投资建设新项目的事项，尚需提交公司股东大会审议。

（二）董事会审核委员会审议情况

经审议，董事会审核委员会认为：公司本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金是基于公司业务开展的实际需要，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项的内容及审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司章程的规定。

综上所述，董事会审核委员会同意公司本次募投项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金的事项。

八、保荐人核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项已经公司董事会审核委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，公司拟使用超募资金、剩余募集资金和自有资金投资建设新项目事项尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定。本次募集资金投资项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金，符合公司经营发展和业务规划需要，有利于公司长远发展及提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

综上,保荐机构对公司本次募集资金投资项目结项、变更并将剩余募集资金、超募资金和自有资金投资建设新项目及永久补充流动资金事项无异议。

(以下无正文)

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于华虹宏力半导体有限公司募集资金投资项目结项、变更及超募资金用于投资新项目和永久补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：


寻国良


李 淳


国泰海通证券股份有限公司
2026年9月4日